

SMIC

千住金属工業株式会社

Beyond Connection
~For Smart Home~

Smart Energy

Smart Living

第21回 半導体・センサ パッケージング技術展

日時 2020年1月15日[水]～17日[金] 10:00～18:00

※最終日のみ17時まで

場所 東京ビッグサイト 西2ホール

お客様各位

拝啓 向寒の候、貴社におかれましてはますますご発展のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、弊社は来る2020年1月15日から1月17日までの3日間、東京ビッグサイトにて開催されます、「第34回ネプコンジャパン」と同時開催される「第21回半導体・センサ パッケージング技術展」に出展致します。昨今、自然災害による大規模な電力供給の停止が度々発生し、地域社会や個人が発電や蓄電を見直し、AI・IoT・センシングという先端技術をまちづくりに活かそうという取り組みが始まられています。今回は、スマートホームに活かされるエレクトロニクスの課題を解決する「はんだ材料の実例」をご紹介します。

ご多用とは存じますが、是非弊社ブースにご来場いただき、展示致しました製品をご高覧くださいますよう、ご案内申し上げます。

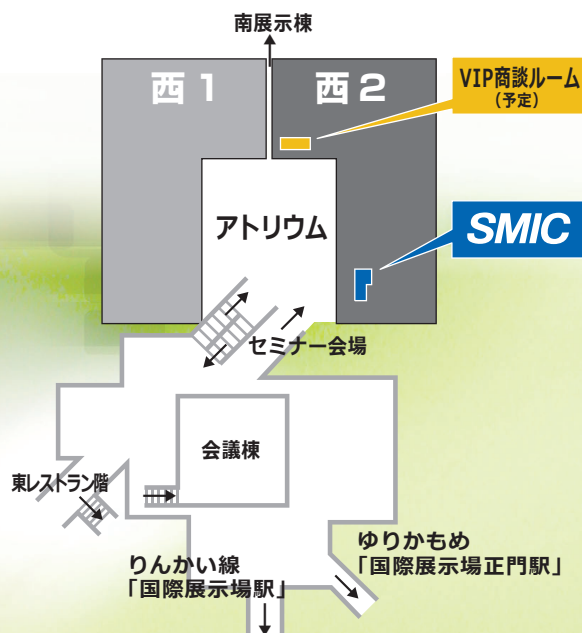
敬具

千住金属工業株式会社

代表取締役社長 鈴木 良一

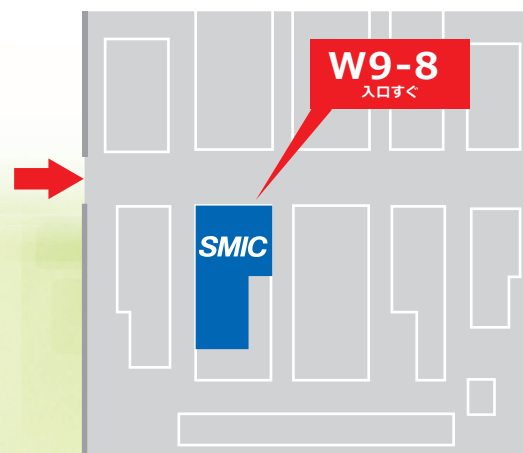
HALL GUIDE

ホールガイド 西展示棟 西2ホール



FLOOR GUIDE

フロアガイド 西2ホール W9-8



セミナー情報・展示製品のご案内 ▶

Beyond Connection ~For Smart Home~



展示内容

ブース内プレゼンテーション

西2ホール W9-8



ソルダペースト
L29-145HF



ソルダプリフォーム

弱耐熱部品への提案～低温はんだ～

AIやセンシングでCPUやGPUの半導体、CMOSなどの光学部品、そしてフレキシブル基板のような弱耐熱部品に対する注目が高まっています。当社から弱耐熱部品への提案として、低温はんだ実装を紹介します。

高出力部品への提案～ソルダプリフォーム～

パワー半導体だけでなく、コンピューターの世界でもハイパフォーマンス化により、放熱が大きなテーマとなっております。これらの高出力部品への提案として、当社からソルダプリフォームを使用したはんだ実装を紹介します。

他会場セミナー

インターネットコンジャパン/専門セッション INJ-1 5Gに向けたはんだ材料開発とソリューション提案

日時 1月15日[水] 10:30～12:00

場所 会議棟

※主催者Webサイトでの事前申し込みが必要です。



開発技術部
ハンダテクニカルセンター
金属課 統轄課長

吉川 俊策

半導体・センサパッケージング技術展/専門セッション ISP-2 パワー半導体向けダイアタッチ材料の開発動向

日時 1月15日[水] 10:30～12:00

場所 会議棟

※主催者Webサイトでの事前申し込みが必要です。



テクニカルセンター 田口研究所
上級研究員

立花 芳恵

出展社による製品・技術セミナー 次世代半導体の放熱性を支える接合材料

日時 1月16日[木] 11:00～12:00

場所 西棟1ホール商談室(6)

西棟の展示ホールへ下りずに回廊をお進み下さい。
※受講無料・事前申し込み不要ですが、定員は先着順となります。



開発技術部
ハンダテクニカルセンター
統轄部長

島村 将人